



2022年3月期 第2四半期決算説明会

2021年11月26日

 **ワイエイシーホールディングス 株式会社**

(証券コード: 6298)

<https://www.yac.co.jp>

▲ 将来見通しに関する記述についての注意事項

このプレゼン資料で述べる将来の当社に関する見通しは、現時点での情報を元に作成したものです。

当社グループのお客様である半導体等の業界は技術革新のスピードが速く、競争の激しい業界です。

また、世界経済、為替レートの変動、各業界市況、設備投資の動向は、当社グループの業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。

したがって、実際の売上高および利益は、このプレゼンテーション資料に記載されている予想数値とは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。

Contents

1. 中間決算の総括 及び ワイエイシイグループの今後の展望

..... 代表取締役社長 百瀬 武文

2. 2022年3月期第2四半期決算概要

..... 取締役常務執行役員
管理統括本部長 畠山 督

3. セグメント別概要

..... 取締役専務執行役員
兼 ワイエイシイメカトロニクス(株)社長 伊藤 利彦

..... 取締役 兼 大倉電気(株)社長 大倉 章裕

..... ワイエイシイマシナリー(株)社長 副島 幸雄

..... ワイエイシイテクノジーズ(株)社長 村野 恒利

4. 質疑応答



1. 中間決算の総括 及び

ワイエイシイグループの今後の展望

…………… 代表取締役社長 百瀬 武文

<2022年3月期 中間決算トピックス>

1. 営業利益・最終利益の急拡大

前年同期比大幅増益。(前年同期比 営業利益2.3倍、最終利益1.9倍)
営業利益716百万円は、直近10年間の中間決算時営業利益としては最高額。

2. 粗利率向上

粗利率が上昇基調。
前年同期の20.0%から26.3%(第1四半期25.6%、第2四半期26.8%)に大幅向上。

3. 自己資本比率向上

自己資本比率42.0%に向上。2017年3月期以来5期振りに40%台を回復。
コロナ借入の返済及び売掛金の回収が進んだことに加え、税引後利益計上に伴う純資産増によるもの。

4. 増配

当中間決算から配当金を2円増配し、1株あたり12円。
期末配当金も12円を予定しており、年間配当金は従来の20円から24円を予定。

1. ワイエイシイグループの当面の最大の目標

1. 東証プライム市場への移行

- ①現在東証1部。引き続き最高位の市場への上場を目指す。
- ②課題は流通株式時価総額の引き上げ。

2. 創立50周年に向け、最高売上・最高益を更新

- ①当社の最大の目的は、利益を通じて社会に貢献すること。
- ②2023年5月に創立50周年を迎えるのを機に、更なる成長を目指す。

2. 最高売上・最高益実現への基本戦略

1. 粗利率向上

(1) 資材調達ของกลุ่ม一元化

- ① 2021年9月よりグループ各社の資材調達部門をHD会社に集約
- ② 発注量をまとめることにより、コストダウンを図る

(2) 標準化の推進 設計・部品等

(3) DX化推進

- ① 営業 受注拡大
- ② 経営効率化
- ③ 直接要員の稼働率

(4) 量産新製品の投入

2. 改革の推進

- (1) 人事総務・財務経理部門のグループ一元化
..... 2022年度実行
- (2) 中国ビジネスの推進 2021年度中実行
- (3) 社内利用品の購入先の集約・・・2021年度中実行
- (4) キャッシュフローの改善
 - ①在庫半減
 - ②売掛金の早期回収
- (5) 財務基盤の強化

3. SDGsの推進

(1) 脱炭素経営

- ① 脱炭素装置設計
- ② 社内省エネの推進

(2) 脱炭素量産新製品

- ① 各種開発進行中

4. M&A

(1) シナジー効果が期待できる製造業

(2) ソフトウェア関連

5. 全員経営の実行推進

3. 過去の業績と中期計画

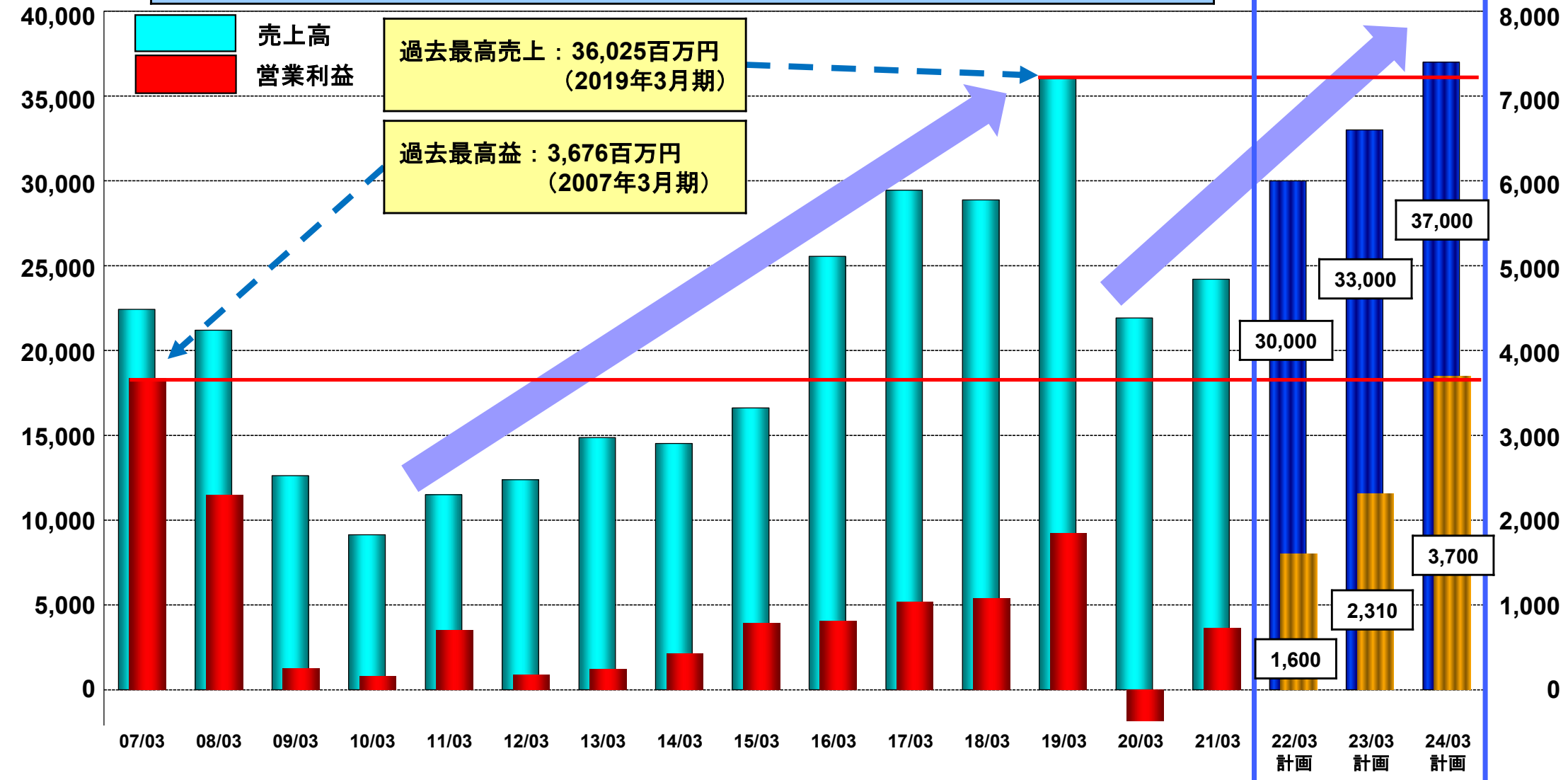
(単位:百万円)

創立50周年を迎える2023年5月の属する決算期で
過去最高売上・最高益の更新を目指す

創立50周年
中期計画

売上高

営業利益





2. 2022年3月期第2四半期決算概要

…………… 取締役常務執行役員
財務統括本部長 畠山 督

2-1 事業結果



(単位:百万円)

	2021年3月期 第2四半期 連結累計期間	2022年3月期 第2四半期 連結累計期間	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
売上高	12,230	11,075	▲1,154	▲9.4%
営業利益 (営業利益率)	311 (2.5%)	716 (6.5%)	404	129.9%
経常利益	307	730	423	137.9%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	273	524	251	91.9%
1株当たり 四半期純利益(円)	30.16	57.66	27.50	91.2%
研究開発費	211	232	20	9.9%
設備投資額	308	153	▲155	▲50.3%
減価償却実施額	282	259	▲23	▲8.3%

2-2 事業別売上・利益



(単位:百万円)

		2021年3月期 第2四半期 連結累計期間	2022年3月期 第2四半期 連結累計期間	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率	備考
メカトロニクス 関連	売上	5,132	6,055	923	18.0%	パワーデバイス向けレーザ アニーラ、スマートフォン向 けキャリアテープが好調
	利益	281	678	396	140.7%	
ディスプレイ 関連	売上	3,669	952	▲2,717	▲74.1%	新型コロナウイルスの影響 により、中国国内における 営業活動に制約
	利益	▲87	▲201	▲113	—	
産業機器 関連	売上	408	371	▲36	▲9.0%	国内外とも、在宅勤務等ラ イフスタイルの変化の影響 を受ける
	利益	▲78	▲49	28	—	
電子機器 関連	売上	3,019	3,696	676	22.4%	電力会社向け及び人工透 析装置が安定的に推移
	利益	79	179	99	125.8%	
HDその他	利益	116	109	▲6	▲5.8%	
合計	売上	12,230	11,075	▲1,154	▲9.4%	
	利益	311	716	404	129.9%	

2-3 事業別受注額・受注残 (連結ベース)



(単位:百万円)

		2021年3月期 第2四半期 連結累計期間	2022年3月期 第2四半期 連結累計期間	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率
メカトロニクス 関連	受注額	4,130	5,624	1,494	36.2%
	受注残	2,716	2,807	91	3.4%
ディスプレイ 関連	受注額	1,575	2,938	1,363	86.5%
	受注残	6,083	5,742	▲341	▲5.6%
産業機器 関連	受注額	345	438	92	26.8%
	受注残	93	226	132	141.0%
電子機器 関連	受注額	3,772	3,849	77	2.0%
	受注残	5,606	6,338	731	13.0%
合計	受注額	9,824	12,851	3,027	30.8%
	受注残	14,500	15,114	613	4.2%

2-4 貸借対照表のレビュー



<資産>

(単位:百万円)

	2021年3月	2021年9月	増減額	備考
現預金	10,009	8,517	▲1,492	借入金の返済
売上債権	10,195	10,038	▲157	
棚卸資産	8,377	7,896	▲481	
その他流動資産	584	418	▲165	
固定資産	8,341	8,129	▲211	
資産合計	37,508	34,999	▲2,508	

<負債・純資産>

(単位:百万円)

	2021年3月	2021年9月	増減額	備考
仕入債務	3,937	3,814	▲122	
その他流動負債	11,451	9,032	▲2,418	短期借入金の返済
固定負債	7,993	7,403	▲590	
純資産	14,125	14,749	623	利益の計上
負債・純資産合計	37,508	34,999	▲2,508	

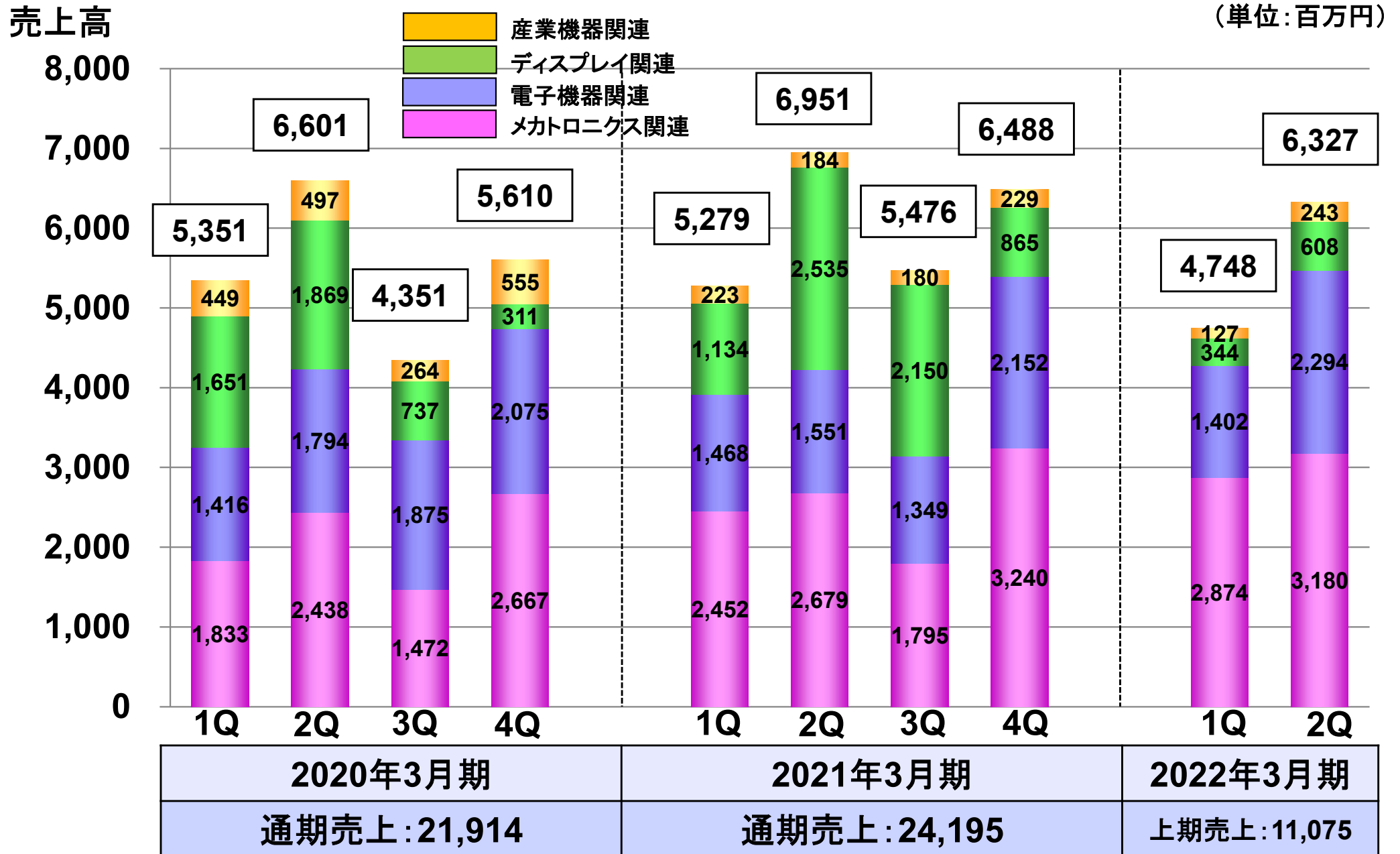
2-5 キャッシュフローのレビュー



(単位: 百万円)

	2021年3月期 第2四半期 連結累計期間	2022年3月期 第2四半期 連結累計期間	主な増減要因	
営業活動によるC/F	1,543	566	増加	純利益の増加
			減少	前受金の減少
投資活動によるC/F	▲166	▲54	増加	
			減少	
財務活動によるC/F	1,210	▲2,053	増加	
			減少	短期借入金・長期借入金の返済
現金及び現金同等物の 期末残高	9,038	8,439	前年度末比1,492百万円減少	

2-6 事業別四半期毎 売上高

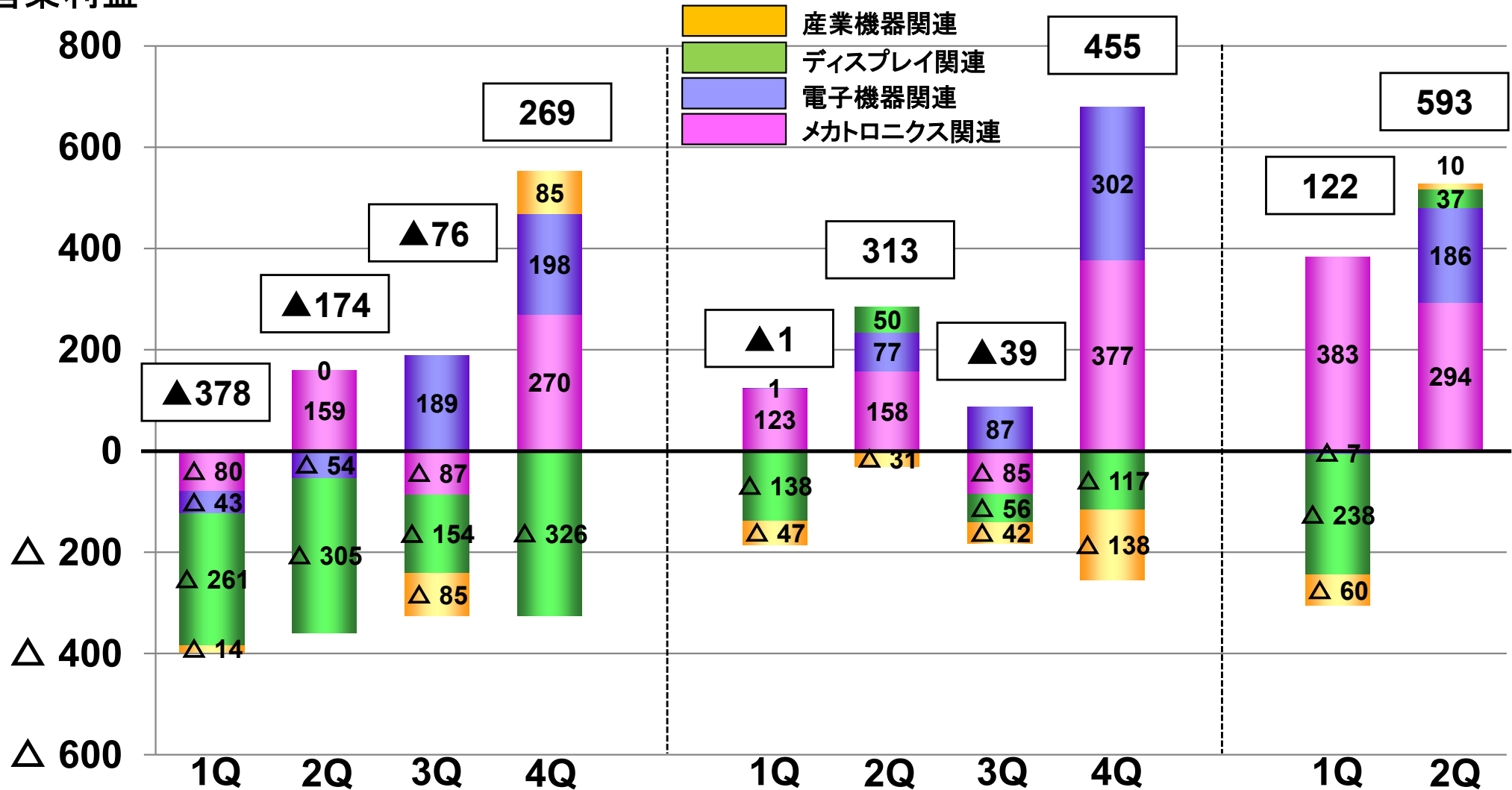


2-7 事業別四半期毎 営業利益



営業利益

(単位:百万円)



2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期
通期営業利: ▲361	通期営業利: 727	上期営業利: 716

2-8 2022年3月期事業計画

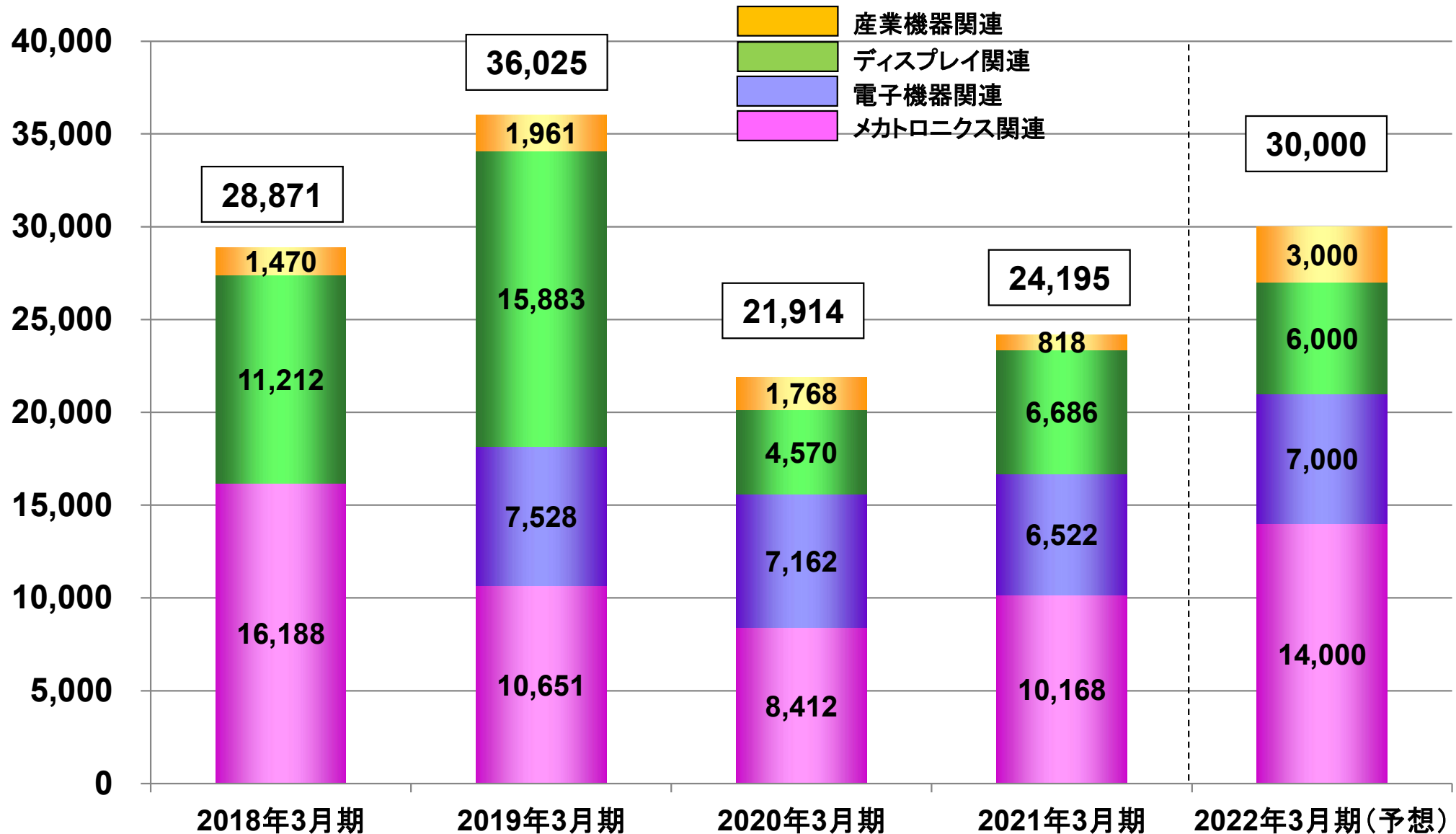


(単位:百万円)

	2019年 3月期 (実績)	2020年 3月期 (実績)	2021年 3月期 (実績)	2022年 3月期 (見込)	前年比 増減額 (見込)	前年比 増減率 (見込)
売上高	36,025	21,914	24,195	30,000	5,804	24.0%
営業利益	1,842	▲361	727	1,600	872	120.0%
経常利益	1,852	▲443	739	1,500	760	102.7%
当期純利益	1,094	▲958	337	800	462	137.0%
1株当たり 当期純利益(円)	121.68	▲106.08	37.19	88.04	50.85	136.7%

2-9 事業別実績及び見通し【売上高】

(単位:百万円)



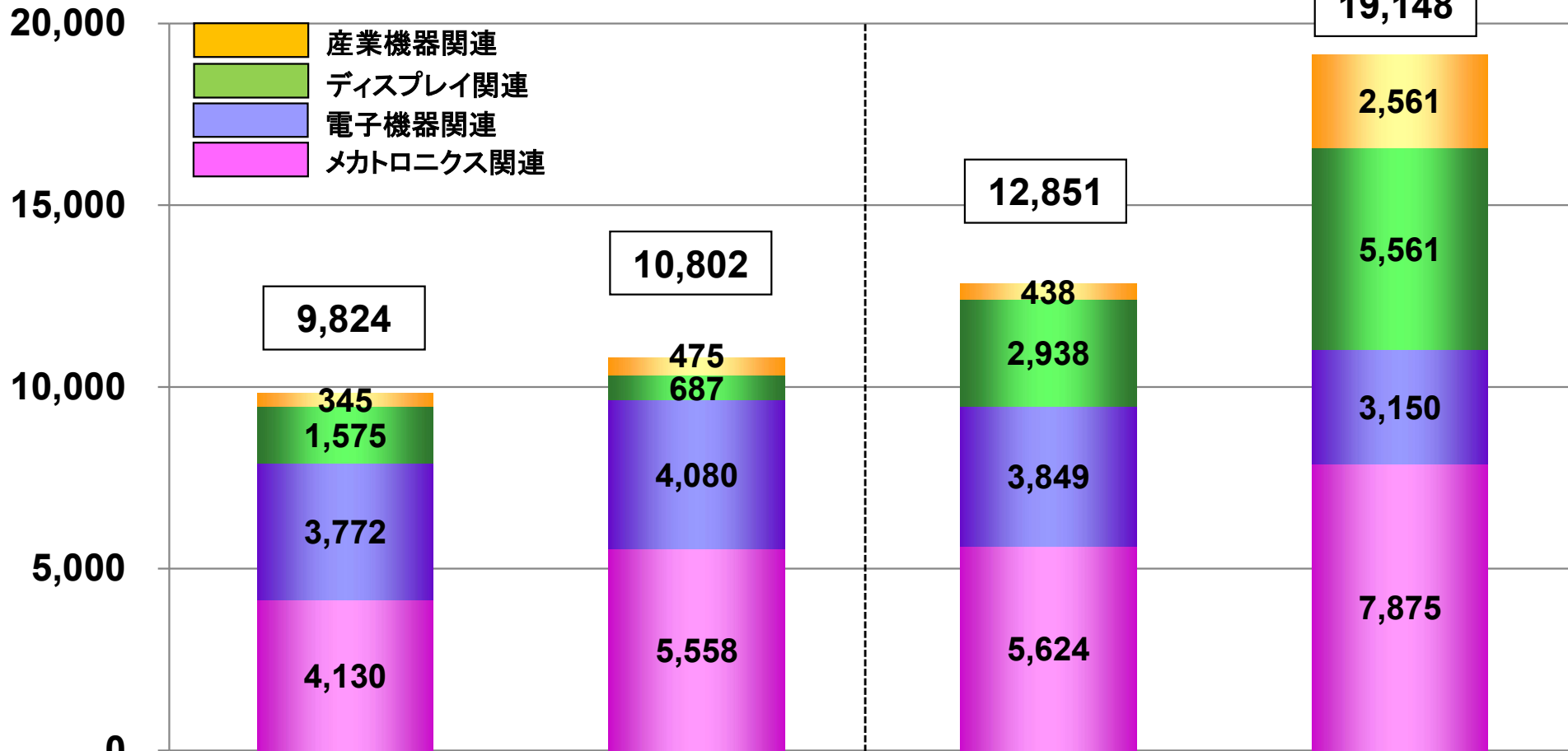
※ 2018年3月期は「メカトロニクス」「ディスプレイ」「クリーニングその他」の3セグメントによる実績

2-10 事業別実績及び見通し【受注】



(連結ベース)

(単位:百万円)



上期	下期	上期	下期(予想)
2021年3月期		2022年3月期	
通期受注高 20,626百万円(実績)		通期受注高 32,000百万円(予想)	

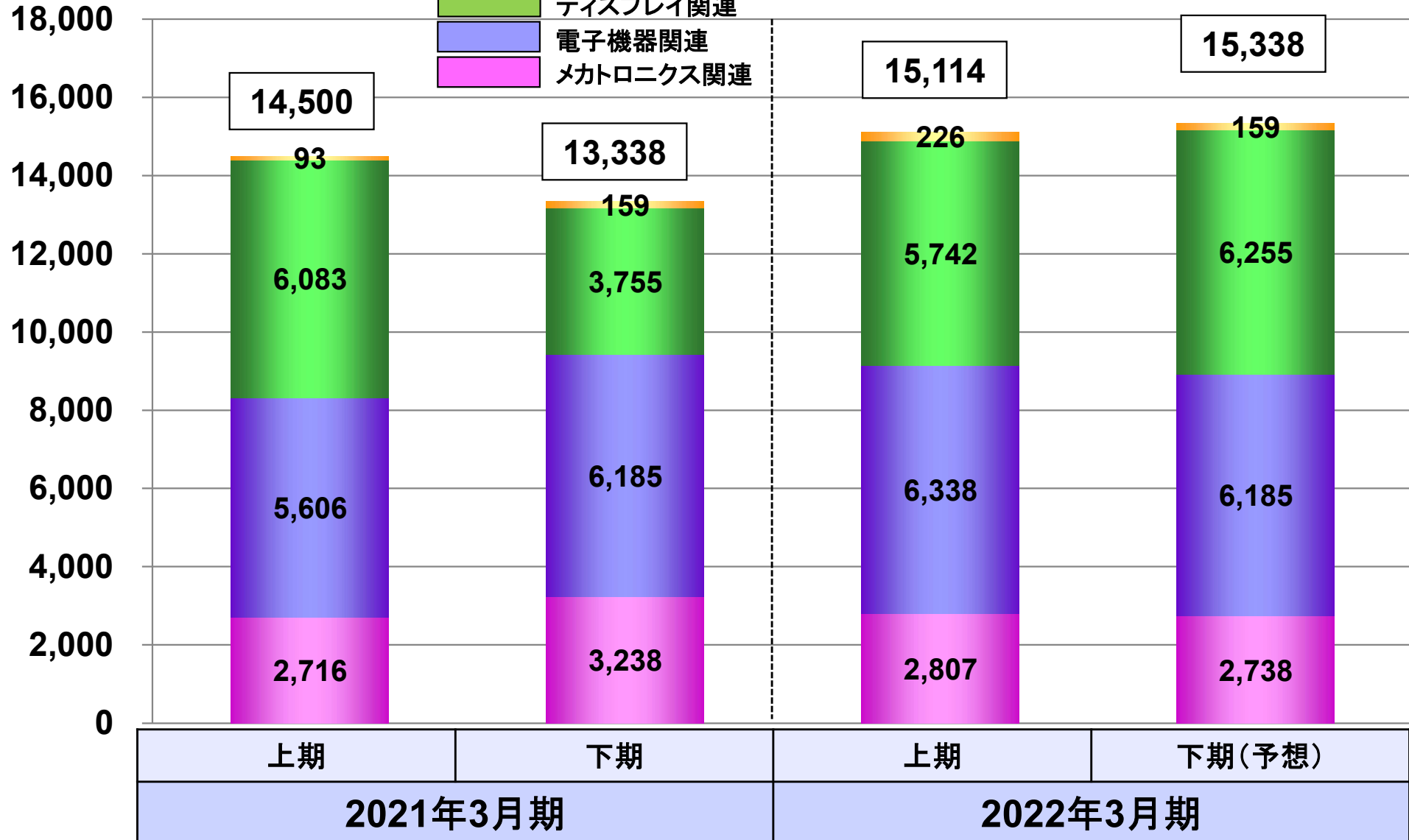
2-11 事業別実績及び見通し【受注残】



(単位:百万円)

(連結ベース)

- 産業機器関連
- ディ스플레이関連
- 電子機器関連
- メカトロニクス関連



3. セグメント別概要

- | | |
|---|-------|
| 取締役専務執行役員
兼 ワイエイシイメカトロニクス(株)社長 | 伊藤 利彦 |
| 取締役 兼 大倉電気(株)社長 | 大倉 章裕 |
| ワイエイシイテクノジーズ(株)社長 | 村野 恒利 |
| ワイエイシイマシナリー(株)社長 | 副島 幸雄 |

3-1 メカトロニクス関連事業



①現況と課題

* 弊社中期経営計画から抜粋

クラウド関連、EV、デジタルシフトの進展で、当関連事業がフォローしている市場は大きな拡大が見込まれます。独占的に販売しているクラウド関連HDD向け装置の需要増対応、パワー半導体・電子部品（レーザーアニーラ・キャリアテープ・自動化装置・切断装置等）の迅速な横展開、コロナ関連商材の販売促進等が課題となります。

②施策

- ・HDDのプロセス装置の次世代対応開発、並びにIoT、AI搭載による付加価値開発。
- ・パワー半導体市場への深耕、5G、センサー市場向けの装置、及び用途開発。
- ・開発中の医療関連ウエットプロセス装置、協働ロボット応用自動化装置等のタイムリーな市場投入。
- ・また、国内外各拠点の連携による製品の競争力強化と安定供給を図ってまいります。



* 各装置詳細はAPPENDIX参照

◆ 5Gスマホ部品・電子部品・EV用テーピング機及びキャリアテープ

： 想定以上伸張

* ガーター：トップライン・利益ともグループの牽引役

◆ パワー半導体関連装置（レーザーアニーラ、パワー半導体用ハンドラー、IPA直接置換乾燥装置）

： 受注・引き合い・開発要請急増

* ビーム、メカトロ（本社、熊本、大分）

◆ HDD用バニッシャー装置

： サプライチェーン問題から受注が後ずれとなっているが、確かな手応え変わらず

* メカトロ（本社）、YSS（シンガポール）

◆ 超音波カッター

： EV、セラミックコンデンサ等に期待

* ダステック

A horizontal banner at the top of the page contains several small images: a golden mechanical part, a grid of solar panels, a view of the aurora borealis, a bright sun with rays, a close-up of solar panels, and a person in a white lab coat working in a laboratory.

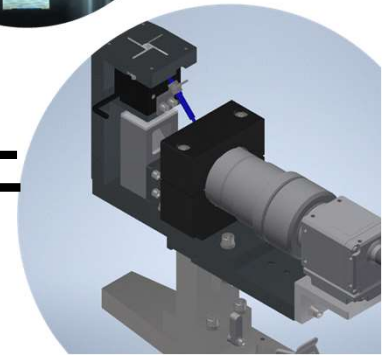
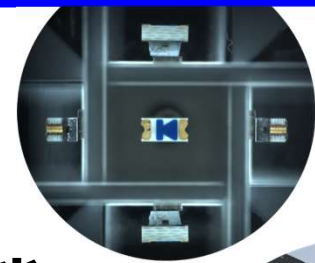
APPENDIX(メカトロニクス関連事業)

① 5Gスマホ部品用テーピング機



外観検査：目視から最終工程のテーピング機に

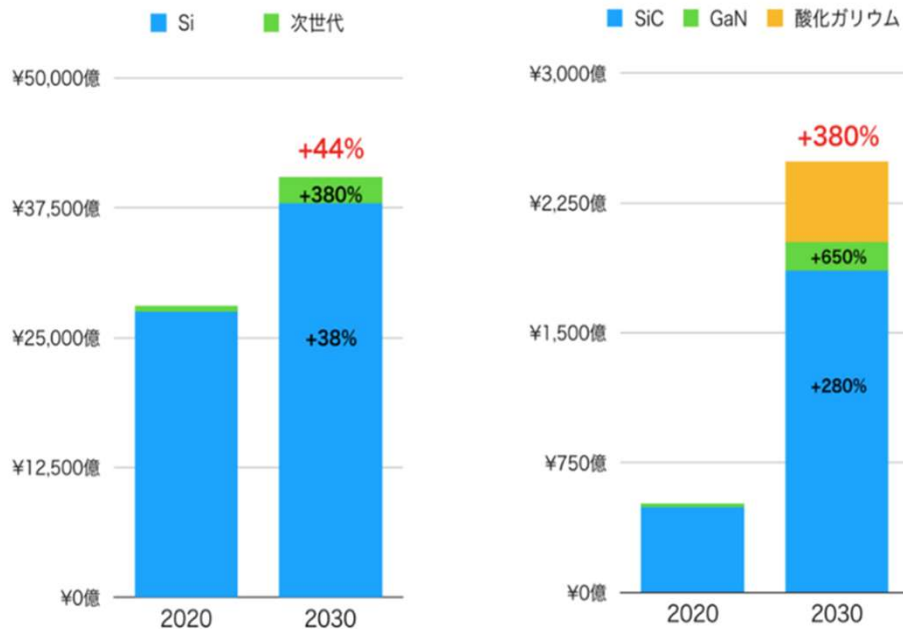
利点：1つのカメラで製品を5面から観た外観検査が可能
キズや異物付着、異品種混入などの不良品の流出防止



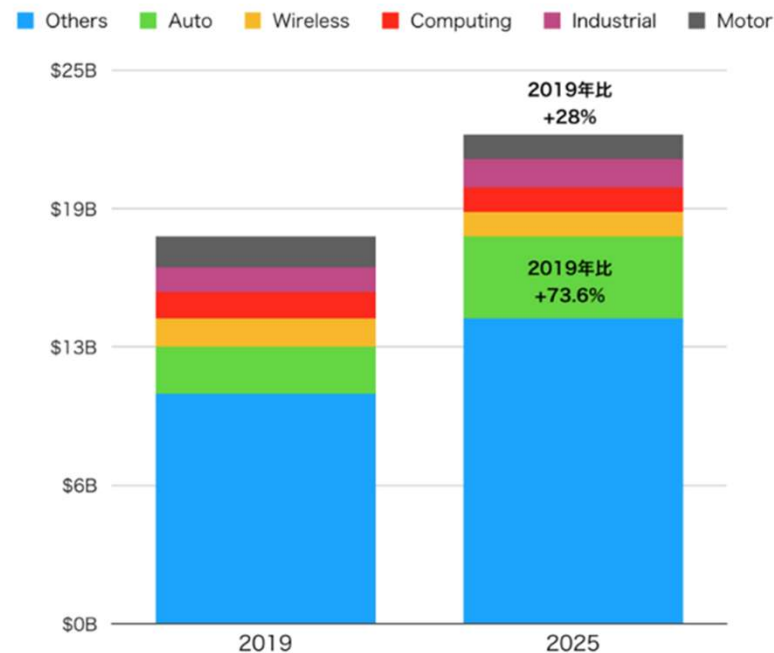
② パワー半導体市場



パワー半導体の市場規模予想 (データ 富士経済)



パワー半導体の市場規模予想 (データ Yole Development)



	2020年	2019年比	2030年予測	2020年比
シリコン	2兆7,529億円	96.0%	3兆7,981億円	138.0%
次世代	514億円	109.6%	2,490億円	4.8倍
合計	2兆8,043億円	96.2%	4兆 471億円	144.3%

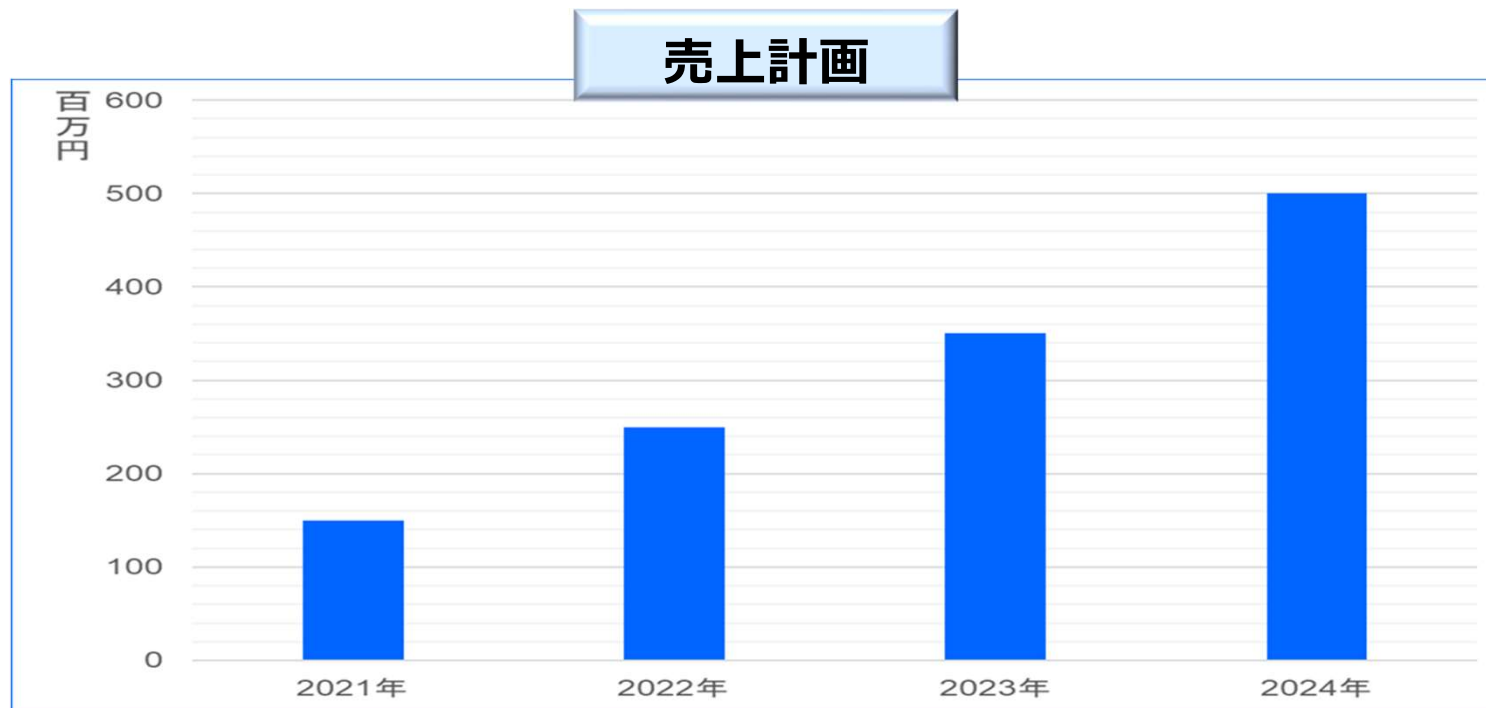
参考-富士経済『SICなど次世代パワー半導体、シリコンパワー半導体の世界市場を調査』

③パワー半導体用ハンドラー



パワー半導体用ハンドラー（電装メーカーより受注）

- HV-AC/DCテスト用ハンドラ
チップ形態パワーデバイス(IGBT,MOS,Diode)の静特性(DC)及び動特性(AC)を測定するため装置
- 3温測定用ハンドラ
複数台のテスター&ハンドラーで測定していた工程を、装置1台で可能に



④IPA直接置換装置



LSI／パワー半導体デバイス製造の洗浄工程（半導体製造工程の約30%）の乾燥工程に使用されている装置。高洗浄乾燥が要求される工程では重要な乾燥装置として高く評価。洗浄後のクリーンな状態の半導体に施す乾燥工程は、表面に水分を残留させない事やパーティクル・金属・有機物などがウエハに付着しない事が大事な要素になっており、その清浄乾燥の結果が直接、歩留まり率、生産率にも比例する重要な工程であり、半導体製造の技術を上げる事となる。

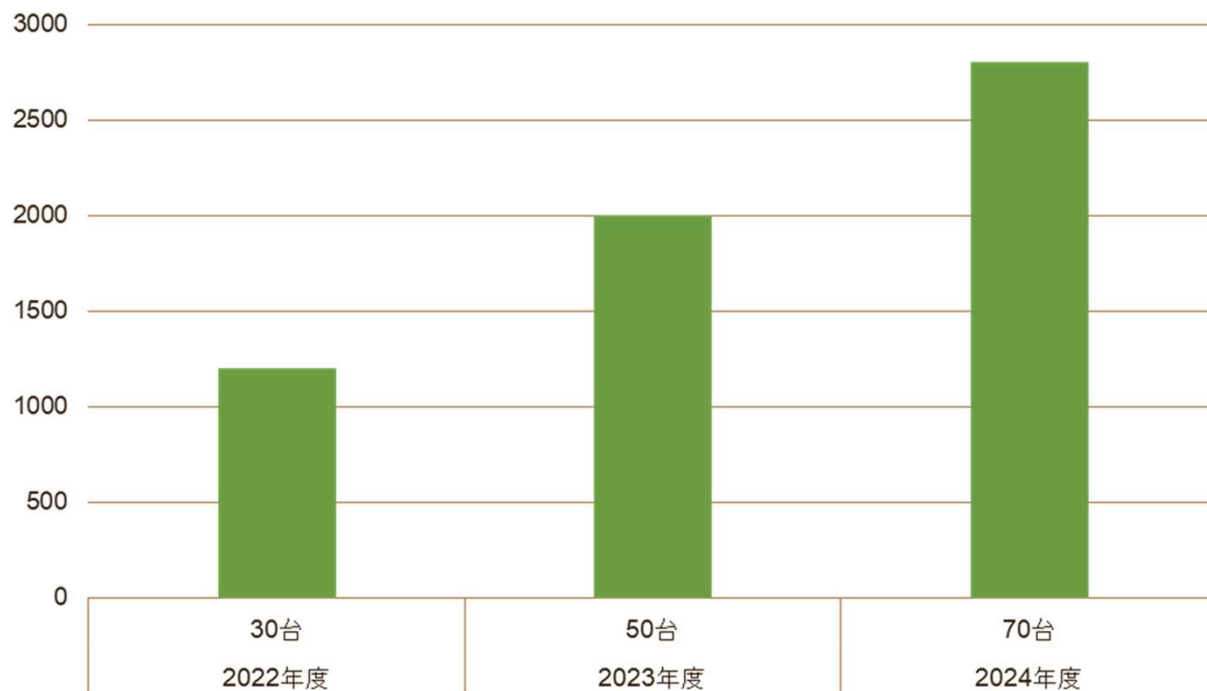
パワー半導体製造に使用されるSi／SiCウエハは、デバイス性能向上のため限界の厚さ（50μm以下）まで薄化したウエハの適用が拡大されており、現行の乾燥工程で使用されている乾燥装置では対応が困難。



⑤ バニツシャー装置



装置出荷台数と売上見込(百万)



※業界動向予測の
2024年～2025年の
HDD生産増加に伴う、
設備投資時期を考慮

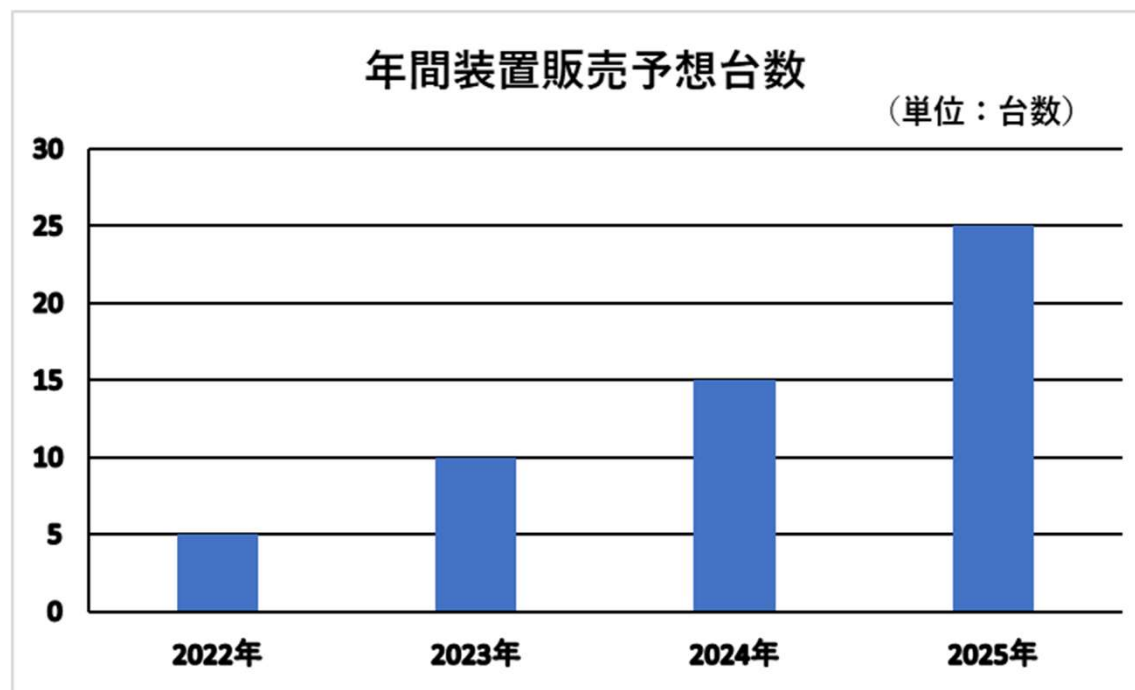
御参考

- ◆当社バニツシャー装置は、HD（ハードディスク）の製造工程にあるバニツシュ工程に使用されている装置（世界シェア100%）であり、必要不可欠な装置です。
- ◆バニツシュ工程とは、ディスク表面の突起、潤滑剤均一化、パーティクル除去などのプロセス用途に使用されており、この工程により、ドライブ内でのディスクとヘッド間の距離を極限まで近づけることができ、ディスク容量の増大や、ドライブ内組込み枚数の増大などHDDの容量増大につながります。

⑥超音波カッター装置



- 最新の超音波カッター技術を使用したチョッパー型切断機。超硬材の刃を垂直に降ろし切断対象物をストレスフリーで切断。次世代車（xEV）やエネルギー貯蔵システム（ESS）向け部品など全固体電池、積層コンデンサ、セラミックパッケージ）の切断用に開発。
- 各部品の積層体の切断を超音波アシストにより切断面の垂れや金属箔の引っ張り接合（短絡）を無くす事ができ製品の歩留まりを向上。
- 適用市場：自動車、電子機器、スマートフォン/通信機器



3-2 電子機器関連事業



①現況

* 弊社中期経営計画から抜粋

人工透析装置は、世界的な糖尿病由来の需要増により拡大の一途を辿ると想定しております。コロナ禍により、旧機種 of 減産調整、また新機種 of 市場投入に悪影響がありました。旧機種 of 販売は今年度第3四半期後半から回復し、新機種につましても来年度秋頃の投入に目途が立ちつつあります。新規採用国での認証を着実に受けること、次の商材の確保が課題です。一方、電力の制御通信機関連は引き続き需要が旺盛ではありますが、急拡大するものではありません。従って、この分野における課題は、今後拡大が見込まれる再生可能エネルギーへの参入が更なる伸張のキーワードとなります。

②施策

医療分野につまましては、既存の人工透析装置の品質向上とコストダウンが最重要であり、一方で当社の技術を生かした新製品開発に取り組んで参ります。また、電力市場については、洋上風力中心に再生エネルギー向け機器の開発を行うとともに、保守の自動化につながる通信装置の開発にも注力してまいります。

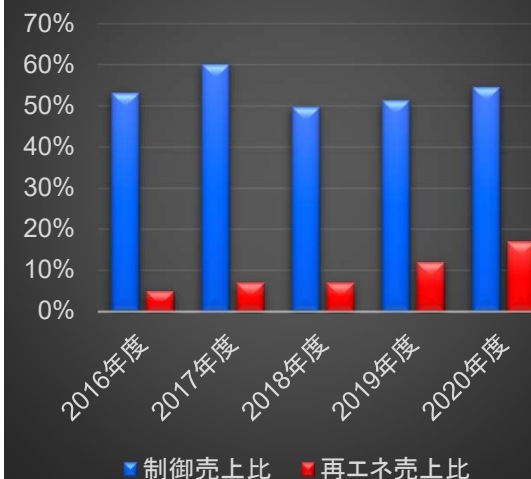
人工透析装置：OEM先向け新製品発売により、今後市場拡大が見込まれる海外市場中心に販売台数増加の見込み

「情報伝送制御装置で電力・水道等の社会的インフラの構築に貢献」

近年SDGs7.2として「2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギー（再エネ）の割合を大幅に拡大させる。」を目的に、日本でも目標に向け10年程前より太陽光発電が増え続けています。これからは洋上風力発電が着目されています。

電力会社では安定供給を維持するため、需要と供給のバランスを取るところが大きな使命であり課題です。安定した発電（原子力、火力）の割合を低くし太陽光、風力、水力発電の割合を増やす為に発電情報、気象情報等の情報を収集し、抑制が必要な場合には制御をする必要があります。

大倉電気売上の制御・再エネ比



3-3 産業機器関連事業①



① 現況と課題

* 弊社中期経営計画から抜粋

ホームクリーニング市場はコロナ禍において急激に縮みましたが、関連業界であるリネンサプライ、特に医療リネンサプライについては、需要は大幅に増加しております。また、クリーニング仕上げのコア技術たるフィルム包装は、脱炭素や脱プラスチックの潮流からエコ仕様のフィルムや紙類が多く取り扱われるようになるEC物流業界において、新たな市場を生み出すものと予想しております。両マーケットへの参入を加速度的に促進することが課題となります。

② 施策

医療リネンサプライにおいて、昨年来開発している入荷チェック時の検査機能の自動化と高精度化により、「安全と安心」を提供いたします。またEC物流については、当社のコア技術の応用により、脱炭素や脱プラスチックの一翼となるべく社会に貢献してまいります。



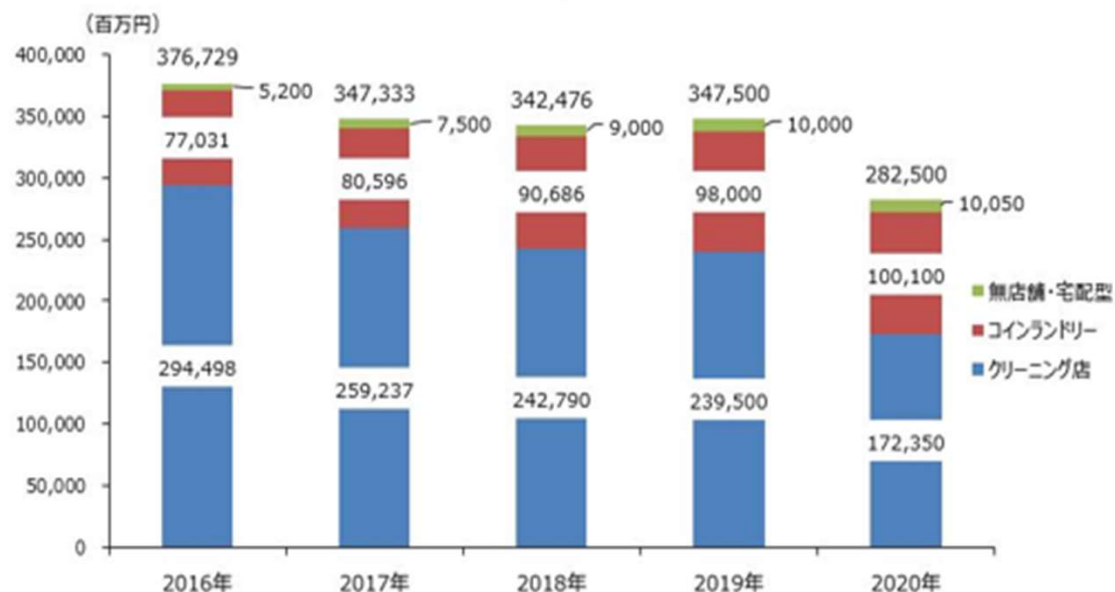
2020年クリーニング市場

クリーニング店 ▲28%(前年度比)

コインランドリー 2%微増

宅配型横這い

事業シフト



3-3 産業機器関連事業②



■ リンサプライへ新製品投入

- ユニフォーム仕上げ機は販売済み。
- 新規投入はトンネル仕上げ機。
- 自動化出来ていない入荷部でX線異物検査装置の投入。
- 消毒品袋を自動破袋機。

■ EC物流への展開

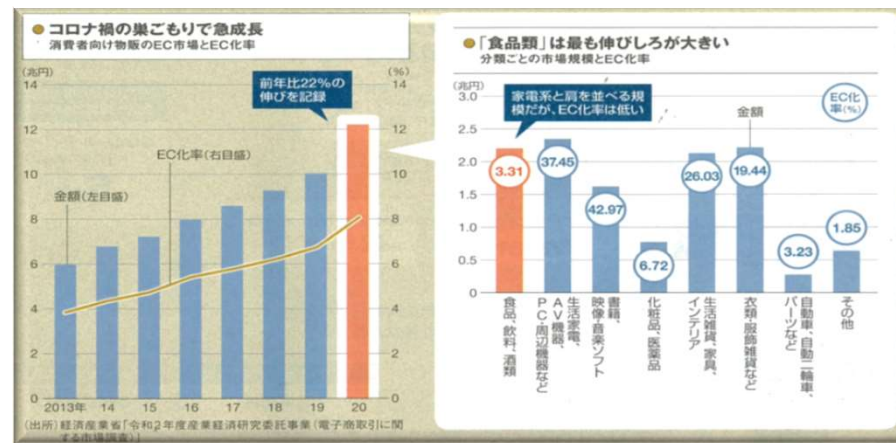
- 物流市場は10年で50%増。
- EC市場は前年比22%増。
- 物流のEC化率は8%。アパレルのEC化20%。
- アパレル物流の自動化は皆無。
- コア技術である包装機を応用。シール方法の最新化や資材のフィルムから紙包装対応。

■ 海外戦略

- 欧米への代理店再構築。
- 中国NETクリーニングのビジネスの加速。



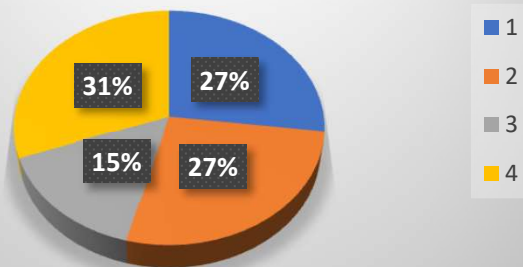
注1. 事業者売上高ベース
注2. 2020年度以降は予測値。2017年度の前年度比は2015年度比、2015年度以前も同じ。



3-3 産業機器関連事業③

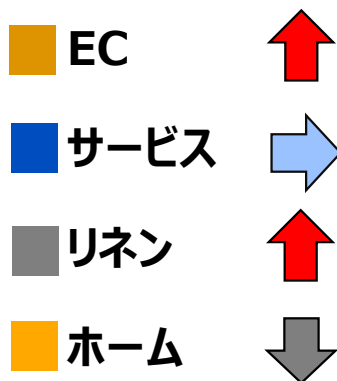
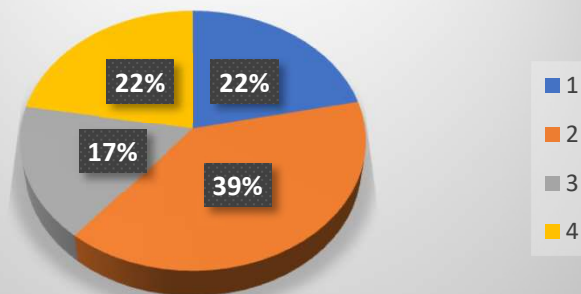


2022/3構成比

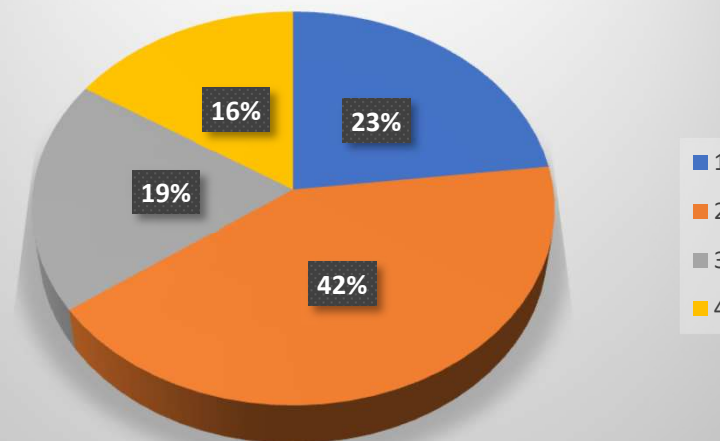


* 全体及び項目別ボリュームについては、現況を鑑み再検討中

2023/3構成比



2024/3構成比



3-4 ディスプレイ関連事業①



① 現況と課題

* 弊社中期経営計画から抜粋

フラットパネルディスプレイ(FPD)業界においては、大型TV用液晶ディスプレイ(LCD)投資が一段落し、有機ELディスプレイ(OLED)投資は大型基板の量産開発への取組みが見られるものの、現在は調整局面にあります。当関連事業におきましては、自社の強みを活かせる分野への特化（前事業年度におけるWET事業からの撤退等）と拡大（熱処理装置の応用拡大）によりこの局面を乗り越え、引き続き体質強化を図ることが課題となります。

② 施策

技術とコストの両面からブラッシュアップしシェアアップさせるとともに、メンテナンス、サービスの積極的な展開（提案型営業）により、ベース事業に育成してまいります。一方、飛躍的拡大のため、当社のコア技術と他社技術とのコラボレーションによる商品開発の促進と、FPD業界以外の市場への投入を進めてまいります。

現況

国内パネルメーカーの設備投資減少に伴い、海外パネルメーカーへの販売シフトを実施してきたが、海外装置メーカーの台頭によるコスト競争及び、納入装置の不具合により、近年は大幅減益となりました。

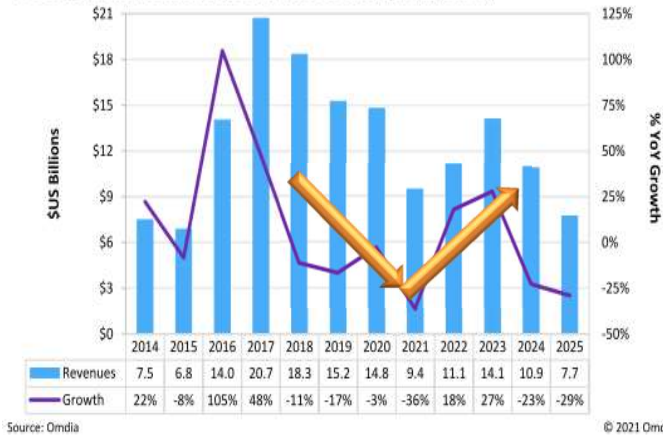
特に、2019年度は、ウェット装置事業から完全撤退、損金引き当てにより大きく収益が悪化し、2020年度にはディスプレイ関連事業の利益体質強化に向けた構造改革を敢行し現在に至っております。

3-4 ディスプレイ関連事業②



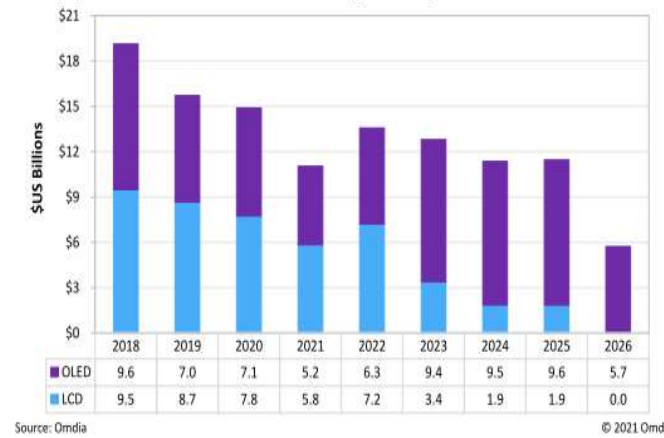
改善策

FPD equipment revenues & growth rate forecast (January 2021)

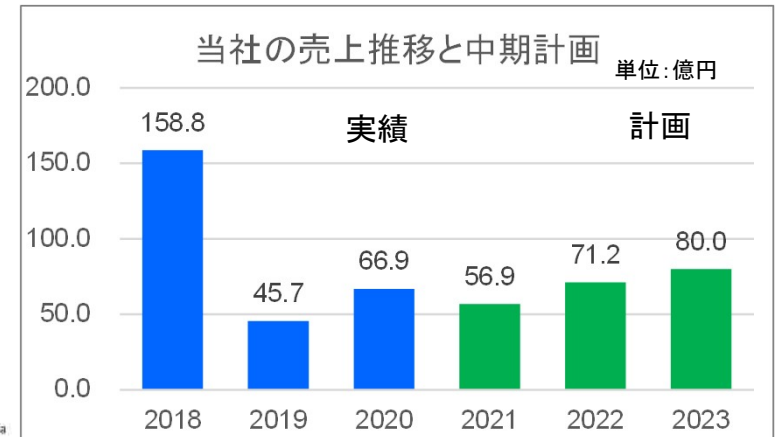


FPD装置の収入と成長予測(出所:OMDIA)

FPD equipment revenues & OLED vs LCD forecast (June 2021)



FPD装置 (LCD及びOLED)の収入予測(出所:OMDIA)



FPD製造装置への設備投資はコロナ禍の影響で計画の遅れはあるものの、中期的に継続する見込みであり、当社の中期計画に対して需要は旺盛であります。

国内外での付加価値の高いプロセスでの実績面及び不具合解決による対策のノウハウを得たことによる強力な提案力により、大規模装置の受注を獲得し、業績の改善を図ってまいります。

3-4 ディスプレイ関連事業③



FPD装置事業

- ・大規模設備投資が継続する中国パネルメーカーに向けて、**高精度アニール装置、高密度プラズマドライエッチング装置**を販売。
- ・AMOLED製造装置の実績面で先行する韓国メーカーに対し、中国パネルメーカーでの実績を経て大規模な装置受注を獲得。**2022年1月**から、中国顧客向けに複数台の**AMOLEDアニール装置**を出荷。
- ・国内でのIGZO製造装置の実績面を認められ、中国パネルメーカーからの大規模な装置受注を獲得。**2021年11月**から、中国顧客向けに複数台の**高温アニール装置**を製作開始。
- ・**2022年度**から、顧客が要求する高技術を実現可能とした**新プラズマソース搭載の高密度プラズマドライエッチング装置**を販売開始。

◆業績の改善、事業の安定化

○ターゲットを絞り、付加価値の高い装置販売に注力し、利益率の改善を図る。

○FPD装置メーカーと技術的協業による新技術を付加したFPD製造装置をパネルメーカーに提案、販売を促進する。



G6高密度ドライエッチング装置外観



G10.5アニール装置外観

3-4 ディスプレイ関連事業④



FPDビジネス基盤の安定化

●装置販売強化

- ・既存顧客を対象に、プロセス変更や部分増設、更新需要の装置を提案

●カスタマーサポート強化

- ・日中韓台 **1,000台超**の実績装置を対象に、保守点検・部品等の販売を強化
- ・装置の高効率化提案により、**CO2排出量の削減**を提案 

●連携強化

- ・同業他社に向け、当社のコア技術、部品、ユニット等を供給
- ・産学公連携を通じ、さまざまな**社会課題解決**につながるイノベーション創出 

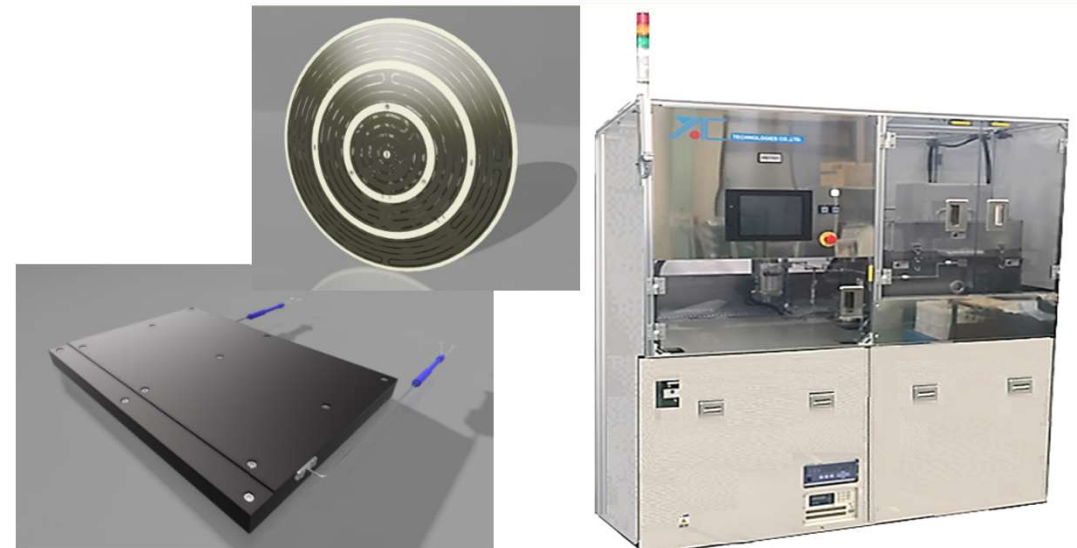
コア技術をさまざまな市場へ

●精密熱処理技術

- ・**半導体製造設備**用ヒーターを販売開始
- ・小型ホットプレート用ヒーターを販売開始
- ・金型予熱用ハイパワーヒーターを販売開始

●プラズマ技術

- ・R&D用プラズマドライエッチング装置を
電子部品市場等、様々な分野に向け販売開始





さあ今日も、

ときめきと感動の日々であれ！

数字の処理について

記載されている金額は百万円未満を切り捨て、その比率については小数第2位を四捨五入しています。

しなやか先端技術企業集団
ワイエイシイグループ